



特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6429093号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

半導体結晶体の加工方法および半導体結晶体の加工装置

特許権者
(PATENTEE)

滋賀県東近江市札の辻2丁目6番9号

株式会社プラウド

発明者
(INVENTOR)

八戸 啓

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2016-024258

出願日
(FILING DATE)

平成28年 2月11日(February 11, 2016)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成30年11月 9日(November 9, 2018)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成30年11月 9日(November 9, 2018)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

宗像直子

